

附件一：会议议程

2014中国半导体器件高可靠性技术论坛 议程

日期	时间	主题	主持人	演讲题目	演讲嘉宾	
11月27日 上午	8:30 — 9:00			签到		
	9:00 — 9:30			大会开幕致辞 中国半导体行业协会副理事长 陈贤 先生、陕西半导体行业协会理事长 邱义路 先生 西安高新区高新技术企业协会理事长 刘明华 先生		
	9:30 — 10:00	电源系统应用	罗义	前沿技术功率器件对系统之可靠度评估	张育铭 博士 台达电子(Delta)工业股份有限公司 电源系统事业群总经理	
	10:00 — 10:30			高效能电能转换器之双模控制	罗有纲 博士 光宝科技(LiteOn)股份有限公司 产品竞争力中心技术总监	
	10:30 — 10:45			茶歇		
	10:45 — 11:15			暂未确定	艾默生 (Emerson)网络能源有限公司	
	11:15 — 11:45			中小功率电源系统设计及可靠度对功率器件的要求	Y. H Liew 先生 赛尔康(Salcomp)股份有限公司 全球技术总监 林嘉杰 助理 赛尔康(Salcomp)股份有限公司 研发部	
	11:45 — 12:15			高效率汽车发电机整流器研制	陈志维 教授 国立虎尾科技大学 车辆工程系	
	12:15 — 12:30			现场交流与主题评论	罗义 总经理 西安芯派电子科技有限公司	
	12:30 — 13:30			午餐/休息		
14:00 — 14:30					氮化物半导体功率元件之磊晶制程元件技术与应用趋势	傅毅耕 博士 台湾工业技术研究院 电子与光电研究所经理
14:30 — 15:00					宽禁带半导体电力电子器件的可靠性评估	张安平 教授 西安交通大学 电信学院

11月27日 下午	15:00 — 15:30	器件设计与制程技术	赵小宁	IGBT器件产业化的可靠性挑战	陈智勇 博士 宁波达新半导体股份有限公司 总经理
	15:30 — 15:45			茶歇	
	15:45 — 16:15			深槽型超结的特点和优化	王飞 博士 华虹宏力半导体制造有限公司 工艺集成科科长
	16:15 — 16:45			超结功率器件现状及研发展望	刘侠 博士 西安芯派电子科技有限公司 研发总监
	16:45 — 17:00			现场交流与主题评论	赵小宁 秘书长 中国半导体行业协会分立器件分会

日期	时间		主持人	演讲题目	演讲嘉宾
11月28日 上午	8:30 — 9:00			签到	
	9:00 — 9:30	封测与质量保障	何晓宁	功率器件过程质量控制与可靠性保障	贾新章 教授 西安电子科技大学 微电子学院
	9:30 — 10:00			LED及功率器件可靠性评估方法	Toshikatsu Nagasawa 部长 日本HIRAYAMA株式会社技术部
	10:00 — 10:30			半导体产品的可靠性测试—温度冲击测试和快速温变测试	Ralf Touby 先生 德国Votsch 亚太区总经理
	10:30 — 10:45			茶歇	
	10:45 — 11:15			先进封测技术提升功率器件可靠性	董勇 先生 天水华天微电子股份有限公司 工程部部长
	11:15 — 11:30			现场交流与主题评论	何晓宁 主任 西安市集成电路产业发展中心
	11:30 — 11:45			大会闭幕致辞	何晓宁 主任 西安市集成电路产业发展中心
	11:45 — 13:30			午餐/休息	

附：

一、出席研讨会的参会领导：

中国半导体行业协会副理事长 陈贤 先生

中国半导体行业协会分立器件分会秘书长 赵小宁 先生

陕西省半导体行业协会理事长 邱义路 先生
西安市集成电路产业发展中心主任 何晓宁 先生
西安高新区高新技术企业协会理事长 刘明华 先生

二、主持人工作包括：

1. 开场引言
2. 介绍演讲嘉宾履历
3. 主持现场交流及问答环节
4. 进行本场演讲的主题评论与总结